

证券代码： 600584

证券简称：长电科技

江苏长电科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他 （请文字说明其他活动内容）</div>
参与单位名称 （排名不分先后）	<div>易方达基金、银华基金、诺安基金、鹏华基金、大成基金、国泰基金、天弘基金、交银基金、汇丰基金、鑫元基金、太平基金、西部利得基金、长信基金、浦银安盛基金、光大保德信、东吴基金、华商基金、财通基金、景顺长城、宏利基金、中银资管、中银香港、中银保诚、友邦人寿、高信百诺、中邮资本、国华兴益、交享越渤源资产、润晖投资、重阳投资、源乐晟、混沌投资、从容投资、胤胜资产、域秀资产、盛钧投资、清曜资本、复胜资管、宁远资本、上海古曲私募、上海大朴资管、上海万纳基金、天瑞万合、杭银理财、杭州博衍基金、中信资管、中信建投自营、中泰证券自营、国泰海通证券自营、中原证券自营、上海证券资管、山证资管、华西投资、上海世诚投资</div> <div>Blackrock、Fidelity Management and Research (FMR)、Goldman Sachs Asset Management、T Rowe Price、Invesco、Allianz Global Investors、Lazard Asset Management、Wellington、Baillie Gifford、Temasek Holdings Pte Ltd (P), Singapore、Bridgewater、Millennium、Point72、Man Group、Farallon Capital、Maverick Capital、Marshall Wace Asset Management、Dymon Asia、Neuberger Berman、American Century、Pinpoint、Trivest Advisors、Broad Peak、Perseverance Asset Management、Stonelake Asset Management、Helved Capital、REST、AIA Group、My Alpha Management、Amova Asset、North Rock Capital、Red Gate Asset</div>

	<p>Management、Triata Capital、Hao Capital、TD AM、Mackenzie Investment、Sumitomo Mitsui DS Asset Management、APS Asset Management、Cephei Capital、Keywise Capital、Keystone Investors</p> <p>瑞银证券、瑞穗证券、花旗证券、摩根大通证券、伯恩斯坦证券、中泰证券、申万宏源、平安证券、东吴证券、华泰证券、东北证券、光大证券、浙商证券、南京证券、西部证券、天风证券、华源证券等</p>
时间	2025 年 10 月 29 日- 12 月 25 日
地点	上海、北京、济南、江阴、香港
上市公司接待人员	<p>公司董事、首席财务长(CFO)：梁征先生</p> <p>公司副总裁：吴宏鲲先生</p> <p>投资者关系团队</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：公司下半年业绩情况？</p> <p>答：前三季度公司实现营收总额 286.7 亿元，同比增长 14.8%。Q3 单季公司实现营收 100.6 亿元，同比增长 6%，创历史同期 Q3 的营收新高。前三季度，公司重点应用领域市场持续回暖，热点应用及国产替代需求带动订单增加。公司整体产能利用率稳步提升，部分产线接近满产状态。目前公司正加速转型，优化产品结构，不断聚焦先进封装产能。前三季度，运算电子、工业及医疗电子、汽车电子业务营收分别增长约 70%、40% 和 30%，增长势头显著。公司将紧扣市场脉搏，把握技术发展方向，更好服务国内外客户，进一步提升市场份额。前三季度平均毛利率 13.7%。其中 Q3 毛利率 14.3%，较去年同期明显提升，主要得益于产能利用率提升及产品结构优化。在营运费用方面，公司持续加大各项费用管控力度。管理费用增幅较大，主要原因是晟碟半导体并表及公司在建、爬坡期及导入期工厂的相关运营费用增加。同时，公司持续加大研发投入，聚焦先进封装技术突破、工艺升级、技术服务及协同设计等方面。前三季度研发投入总额达 15.4 亿元，同比增长接近 25%，呈加速增长趋势。前三季度实现归属于上市公司股东净利润 9.5 亿元。其中 Q3 单季实现</p>

归属上市公司股东净利润 4.8 亿元，同比增长 5.7%，环比大幅增长 80.6%。

问题二：公司今年的资本开支计划及明年的资本开支计划？

答：资本支出方面，公司目前仍维持全年 85 亿元的开支计划不变。关于下一步扩产规划，公司将基于对市场的研判，包括人工智能需求带动的相关需求快速增长的情况下，继续聚焦高端产能布局。产能结构规划将围绕以下几方面展开：一是应用领域倾斜，结合未来市场预判，保持向汽车电子、运算存储、高密度电源等领域适度侧重；二是深化客户合作，始终重视客户关系，持续强化与头部高端客户的绑定；三是加大研发投入，聚焦先进封装技术及前沿领域的突破，推动技术发展与应用需求深度契合。总体来看，结合当前先进封装的旺盛需求趋势，公司将持续加大相关投资力度。明年资本开支计划具体规划将按公司时间表，通常在年初进行披露。

问题三：请问公司产能布局策略及在面临产能紧张的时候如何进行产能调配？

答：长电科技在产能方面的优势，在于公司已构建双循环的产能布局。我们在国内外均拥有充足产能，依托这一布局，可实现“在中国为中国，在海外为海外”的灵活安排，能根据客户具体需求，在区域产能上进行相应匹配。公司也会通过战略规划、年度商业计划等方式提前做好部署，充分预判未来市场需求，力争通过整体产能的均衡布局，满足客户全方位需求。

在产能紧张的情况下，我们的决策会综合考量战略与技术层面的因素、重点大客户的绑定情况等，同时优先保障高附加值订单，以此进行产能分配，助力整体盈利水平稳步提升。我们也期望在业务发展过程中，兼顾盈利与持续健康发展，实现长期业务布局的稳定。

问题四：请问公司对目前及近期行业景气度的看法及对下游应用的市场走势是如何判断的？

答：整个半导体市场仍在延续上行趋势。从技术应用来看，行业正处于承前启后、辞旧迎新的关键阶段。工业和汽车电子领域虽有此起彼伏的波动，但总体保持持续复苏态势。消费类电子，尤其是中国消费类电子的需求在一系列政策推动下，维持平稳发展态势；加之移动终端持续智能化，也进一步拉动了高端产品需求。人工智能生态的持续壮大，带动的不仅是算力芯片，更是整个人工智能生态链各环节的协同发展，整体需求呈现明显增长趋势。

在此过程中，我们仍需做好传统业务的取舍与产品结构的优化，集中力量在主流封装与先进封装领域，对新技术、新产能进行前瞻性布局。从四季度趋势来看，市场将继续保持稳中向上的势头，这一发展方向延伸至 2026 年，大的方向我们认为不会发生变化。

问题五：当前封测价格及公司毛利率趋势？

答：公司已从下半年起逐步落地金价联动机制。尽管金价联动机制在一定程度上缓解了原材料涨价带来的压力，但传导存在一定滞后性。不过，受益于整体业务向好的态势，三季度公司毛利率同比明显改善，提升 2 个百分点。后续公司将针对性地做好服务定价及产品结构优化工作，优先聚焦高毛利产品进行产能分配，提升单位产出利润率。

我们预计国内外工厂的毛利水平后续将持续改善，公司整体毛利率有望实现稳步回升。公司也会通过强化各项管理、提升管理效率进一步夯实这一态势。短期来看，部分投入期的费用会对毛利率指标产生一定压力；但从中长期来看，随着公司高附加值业务转型升级落地，毛利率及盈利能力有望逐步回升。

问题六：公司在存储业务的布局情况，晟碟半导体的经营现

状分析？

答：晟碟工厂在并购后保持健康良性的发展态势，下半年运营表现较上半年进一步改善。长电科技与外方股东持续加大对工厂的联合投入，聚焦新产品的技术迭代与产能扩张。晟碟工厂生产的存储芯片，在人工智能未来发展进程中，无论是数据中心端还是终端侧，均是支撑芯片高速运转的核心环节。

存储产品市场存在周期性波动，但叠加当前人工智能在数据中心与终端侧的新增需求，目前行业已呈现需求大于供给的格局，且这一格局预计在未来一段时间内仍将延续。存储产品自身结构及其模组结构也在持续迭代：过去仅聚焦存储容量提升与生产制程升级，如今不仅新的产品组合不断涌现，更催生了全新业务模式。基于此，长电科技后续将依托晟碟工厂及其他多工厂的存储业务布局，进一步提升企业级 SSD 高端市场份额，尤其聚焦高密度存储类产品的发展。目前该规划已在各工厂间形成协同赋能效应，公司全年存储业务将保持快速增长，相信能为业界对存储产品，特别是先进高密度存储产品的需求提供有力贡献。

问题七：公司在先进封装布局的进展？

答：长电科技依托深厚的技术积累与丰富的量产经验，与国际领先企业保持技术同步发展。公司持续加大先进封装领域的投入，全面覆盖主流技术路线，通过不断优化技术布局与工艺，已构建多层次的封装与测试能力，可满足多个应用领域的需求。公司正持续推动长电微电子晶圆级高端制造项目的产品上量，并按照客户要求加快进行产能扩充。从中期目标来看，公司面向运算类电子业务的收入占比将持续提升。

问题八：请问公司汽车电子的发展情况和后续展望？

答：我们凭借与国际大客户及国内主流车企的紧密合作，以汽车电子核心产品为驱动，带动各类周边汽车电子芯片的成品制造业务发展；值得关注的是，先进封装技术及更高规格晶圆的芯

	<p>片正快速进入汽车电子领域，推动先进封装在该领域的落地规模持续扩大，这与前几年的发展态势存在明显差异，同时面向汽车电子的功率器件、电源管理芯片呈现全面发展态势，在汽车电子架构各主要环节均涌现出新的技术需求与应用场景，因此明年将有更多相关新产品在工厂落地量产。尤其在国內，我们位于上海临港的汽车电子工厂将依托当地完善的汽车电子产业链，在核心客户推动与产业链日趋成熟的背景下逐步发力，上述重点领域的新产品将同步供应国内及海外客户，精准匹配“在中国，为中国”的市场需求，综上，我们对汽车电子业务充满信心，将持续提升汽车电子业务收入占比。</p>
附件清单(如有)	无